

IC CARD AND ITS USAGE METHOD

Publication number: JP2003296688

Publication date: 2003-10-17

Inventor: YOSHIDA HIDEYO; SHIMIZU KATSUMI; KUSANAGI TSUKASA

Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international: **B42D15/10; G06K19/077; H04M1/21; H04Q7/32; B42D15/10; G06K19/077; H04M1/21; H04Q7/32; (IPC1-7): G06K19/077; B42D15/10; H04M1/21; H04Q7/32**

- european:

Application number: JP20020098182 20020401

Priority number(s): JP20020098182 20020401

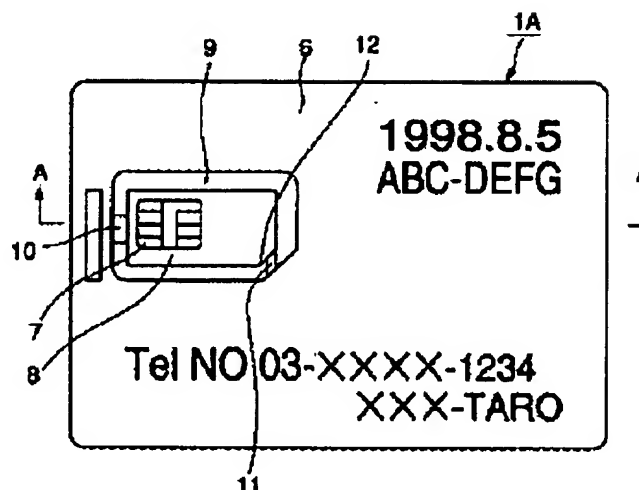
[Report a data error here](#)

Abstract of JP2003296688

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an IC card and its usage method allowing attachment of an IC carrier without an adverse effect of a residual protrusion caused when removing the IC carrier even when the IC carrier is attached to an apparatus.

SOLUTION: The IC card has a tabular frame body and the IC carrier for apparatus attachment removably formed in an inner side of the tabular frame body. A slit part and a bridge part connecting predetermined portions of the tabular frame body via the slit part are provided in an outer circumference of the IC carrier in a space with the tabular body. In the IC card, a bridge formed portion is formed in a place not contacting an inner side face of an IC carrier attaching part when the IC carrier is attached to the IC carrier attaching part provided on the apparatus. In the usage method, the bridge formed portion is attached in a state not contacting the inner side face of the IC carrier attaching part when the IC carrier is attached to the IC carrier attaching part.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-296688
(P2003-296688A)

(43) 公開日 平成15年10月17日 (2003.10.17)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 0 6 K 19/077		B 4 2 D 15/10	S 2 1 2 C 0 0 3
B 4 2 D 15/10	5 2 1	H 0 4 M 1/21	Z 5 B 0 3 3
H 0 4 M 1/21		G 0 6 K 19/00	K 5 K 0 2 3
H 0 4 Q 7/32		H 0 4 B 7/26	V 5 K 0 6 7
審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 9 頁)			

(21) 出願番号 特願2002-98182(P2002-98182)

(22) 出願日 平成14年4月1日 (2002.4.1)

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 吉田 英世

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 志水 克巳

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74) 代理人 100111659

弁理士 金山 聡

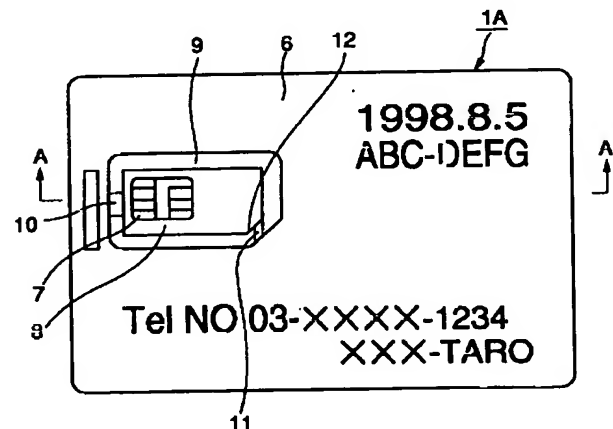
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ICカード及びその使用方法

(57) 【要約】

【課題】 機器にICキャリアを装着した場合でも、ICキャリアを取り外すときに生じた残存突起の悪影響を受けることなく、ICキャリアを装着することができるようにしたICカード及びその使用方法を提供する。

【解決手段】 板状枠体と、前記板状枠体の内側に取り外し可能に形成された機器装着用のICキャリアとを有し、前記ICキャリアの外周には、前記板状枠体と間にスリット部と、前記スリット部を介して前記板状枠体の所定部分とを接続するブリッジとが設けられ、前記ブリッジ形成部分が、前記機器に設けられたICキャリア装着部に前記ICキャリアを装着させた際に、前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない箇所に形成されたICカードと、ICキャリア装着部にICキャリアを装着する際に、前記ブリッジ形成部分を前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない状態で装着する使用方法を特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 板状枠体と、前記板状枠体の内側に取り外し可能に形成された機器装着用のICキャリアとを有するICカードであって、

前記ICキャリアの外周には、前記板状枠体と間にスリット部と、前記スリット部を介して前記板状枠体の所定部分とを接続するブリッジとが設けられ、前記ブリッジ形成部分が、前記機器に設けられたICキャリア装着部に前記ICキャリアを装着させた際に、前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない箇所に形成されていることを特徴とするICカード。

【請求項2】 前記ICキャリアが、その一角部に傾斜状に形成された傾斜状切り欠き辺を有する矩形形状を有していることを特徴とする請求項1記載のICカード。

【請求項3】 前記機器が、携帯電話機であることを特徴とする請求項1記載のICカード。

【請求項4】 前記機器のICキャリア装着部が、前記ICキャリアの長手方向に移動させて装着させるためのスライド部と、前記移動させたICキャリアの先端辺を突き当てて位置決めする突き当たり部とを有し、前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない箇所が、前記スライド部及び前記突き当たり部と接触しない辺であることを特徴とする請求項1記載のICカード。

【請求項5】 板状枠体と、前記板状枠体の内側に取り外し可能に形成された機器装着用のICキャリアとを有するICカードの使用方法であって、前記ICキャリアの外周には、前記板状枠体と間にスリット部と、前記スリット部を介して前記板状枠体の所定部分とを接続するブリッジとが設けられ、前記ICキャリアを機器に設けられたICキャリア装着部に装着する際に、前記ブリッジを切断することで前記板状枠体から前記ICキャリアを取り外した後、前記ブリッジを切断部分が前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない状態で装着することを特徴とするICカードの使用方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ICモジュールを搭載した小型のICキャリアと板状枠体とを備えたICカード及びその使用方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、例えば、携帯電話機の加入者識別票SIM(Subscriber Identity Module)やUIM(User Identity Module)等に使用するICキャリアは、小型の基材(15×25mm程度)にCPUやメモリ及び電極などを一体化させた構成を有するICモジュールを搭載したものが使用されている。そして、携帯電話機のユーザは、必要に応じてSIMやUIM等に使用するICキャリアを、携帯電話機に装着させて使用する場合がある。

【0003】このために、図16に示すように、従来から携帯電話機等の機器には、取り外し可能なICキャリア31を有するICカード30が使用されている。このICカード30は、ICキャリア31の外周において板状枠体32との間にスリット部33が設けられ、またこのスリット部33を介して板状枠体32の所定部分とを接続するブリッジ34が複数箇所に形成されて、ブリッジ34から切り取ることで、ICキャリア35の部分のみを取り外して使用するよう構成されている。

【0004】しかしながら、従来の場合には、ICカード30からICキャリア35を取り外した際に、図17に示すようにICキャリア35の上下左右の外周にブリッジ34の残存突起34aが残る場合が多い。そして、残存突起34aが原因でICキャリア35を携帯電話機等の機器のICキャリア装着部に装着した場合に、ICキャリア35の装着位置が残存突起の長さ分だけズレて正常な位置にセットされずに、ICキャリア35の接点位置と携帯電話機等の機器の接点位置とにくるいが生じ、接触不良を起こす危険性があるという問題がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、携帯電話機等の機器のICキャリア装着部にICキャリアを装着した場合でも、板状枠体からICキャリアを取り外すときに生じた残存突起の悪影響を受けることなく、正しい位置にICキャリアを装着することができるようにしたICカード及びその使用方法を提供する。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明のICカードは、板状枠体と、前記板状枠体の内側に取り外し可能に形成された機器装着用のICキャリアとを有するICカードであって、前記ICキャリアの外周には、前記板状枠体と間にスリット部と、前記スリット部を介して前記板状枠体の所定部分とを接続するブリッジとが設けられ、前記ブリッジ形成部分が、前記機器に設けられたICキャリア装着部に前記ICキャリアを装着させた際に、前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない箇所に形成されていることを特徴とする。

【0007】また、本発明のICカードは、前記ICキャリアが、その一角部に傾斜状に形成された傾斜状切り欠き辺を有する矩形形状を有していることを特徴とする。

【0008】更に、本発明のICカードは、前記機器が、携帯電話機であることを特徴とする。

【0009】また、本発明のICカードは、前記機器のICキャリア装着部が、前記ICキャリアの長手方向に移動させて装着させるためのスライド部と、前記移動させたICキャリアの先端辺を突き当てて位置決めする突き当たり部とを有し、前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない箇所が、前記スライド部及び前記突き当た

り部と接触しない辺であることを特徴とする。

【0010】また、本発明のICカードの使用方法是、板状枠体と、前記板状枠体の内側に取り外し可能に形成された機器装着用のICキャリアとを有するICカードの使用方法であって、前記ICキャリアの外周には、前記板状枠体と間にスリット部と、前記スリット部を介して前記板状枠体の所定部分とを接続するブリッジとが設けられ、前記ICキャリアを機器に設けられたICキャリア装着部に装着する際に、前記ブリッジを切断することで前記板状枠体から前記ICキャリアを取り外した後、前記ブリッジを切断部分が前記ICキャリア装着部の内側面と接触しない状態で装着することを特徴とする。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明のICカードの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係るICカードの平面図、図2は、図1のA-A線断面図、図3は、図2に示す状態においてICキャリアを板状枠体から取り外した状態を示す断面図、図4は、本発明の第1実施形態に係るICカードにおいて、ICキャリアを板状枠体から取り外した状態を示す一部平面図、図5は、本発明の第1実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図、図6は、本発明の第1実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図、図7は、本発明の第2実施形態に係るICカードの平面図、図8は、本発明の第2実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図、図9は、本発明の第2実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図、図10は、本発明の第3実施形態に係るICカードの平面図、図11は、本発明の第3実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図、図12は、本発明の第3実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図、図13は、本発明の第4実施形態に係るICカードの平面図、図14は、本発明の第4実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図、図15は、本発明の第4実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図、図16は、従来のICカードを示す平面図、図17は、従来のICカードから取り外したICキャリアの平面図である。

【0012】まず、本発明の第1実施形態に係るICカードを、図1乃至図6に基づいて説明する。第1実施形態に係るICカード1Aは、ICキャリア8を携帯電話

機等の機器のICキャリア装着部に対して装着する際に、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12側を先頭にして長手方向にスライドさせて装着させる装着方式に適する構成を有するものである。

【0013】このICカード1Aは、コアシート2と、コアシート2の両面に設けられたオーバーシート3、4とにより積層されたカード基材5により、このカード基材5のうち外側の枠体である板状枠体6と、この板状枠体6の内部に設けられて必要に応じて、板状枠体6から分離可能に形成したICモジュール7を有するICキャリア8とにより構成されている。尚、コアシート2とオーバーシート3、4は、塩化ビニル樹脂、PET-G等の樹脂シートなどからなる。

【0014】ICキャリア8は、略矩形形状を有し、更にその一方の角部が傾斜状に切り欠き形成された切り欠き辺12を有している。図1においては、ICキャリア8の右下の角部が傾斜状の傾斜状切り欠き辺12を有している。また、ICキャリア8の周縁と板状枠体6との間には、カード基材5を打抜いて形成されたスリット部9が設けられている。

【0015】ICキャリア8の周辺において、図1に示すように、ICキャリア8の左側辺と傾斜状切り欠き辺12の所定箇所とは、スリット部9を介して板状枠体6と接続状態となるブリッジ10、11がそれぞれ備えられている。ICキャリア8は、図2及び図3に示すように、上方または下方から圧力を加えて押し出すことで、ブリッジ10、11が切断され、板状枠体6からICキャリア8を分離させることができる。

【0016】ICキャリア8を板状枠体6から取り外して分離させた場合には、図4に示すように、ブリッジ10、11の中間部分で切断されるため、ICキャリア8の外周の所定部分にブリッジ10、11から切断させ後に生じる、ICキャリア8側における残存突起10a、11aが残った状態となることが予測される。また、板状枠体6側にも、板状枠体6側における残存突起10b、11bが生じる。

【0017】次に、板状枠体6から取り外したICキャリア8を、携帯電話機等の機器のICキャリア装着部に対して装着する場合を、図5及び図6に基づいて説明する。図5に示した携帯電話機等の機器13のICキャリア装着部14は、ICキャリア8のICモジュール7の接続端子と接触させるための装着部接続端子15と、ICキャリアの長手方向に移動させて装着させるためのスライド部16a、16bと、前記移動させたICキャリア8の先端辺を突き当てて位置決めする突き当たり部17とを有するガイド枠18を有している。

【0018】ICキャリア装着部14にICキャリア8を装着させる場合には、図6に示すように、ICキャリア8の接続端子が装着部接続端子15と接触可能とする状態（図6において、ICキャリア8の接続端子は裏側

にくる)で、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12側を先頭にして、ICキャリア8をスライド部16a、16bの間に挿入させ、突き当たり部17に突き当てて装着状態とする。

【0019】この場合において、ICキャリア装着部14に装着されたICキャリア8の残存突起10a、11aは、ガイド枠18のスライド部16a、16bや突き当たり部17と接触しない箇所にくるので、残存突起10a、11aに影響されることなくICキャリア装着部14のガイド枠18の内部に装着される。これにより、ICキャリア8の接続端子がICキャリア装着部14の装着部接続端子15と確実に接触状態とさせることができる。

【0020】次に、本発明の第2実施形態に係るICカードを、図7乃至図9に基づいて説明する。第2実施形態に係るICカード1Bは、ICキャリア8を携帯電話機等の機器のICキャリア装着部に対して装着する際に、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12が形成された側と反対側の辺を先頭に、ICキャリア8の長手方向にスライドさせて装着させる装着方式に適する構成を有するものである。

【0021】第2実施形態に係るICカード1Bには、図7に示すように、ICキャリア8の右側辺と傾斜状切り欠き辺12の所定箇所とに、スリット部9を介して板状枠体6と接続状態となるブリッジ11、19がそれぞれ備えられている。ICキャリア8は、上方または下方から圧力を加えて押し出すことで、ブリッジ11、19を切断させ、板状枠体6からICキャリア8を分離させることができる。

【0022】ICキャリア8を板状枠体6から取り外して分離させた場合には、図8に示すように、ICキャリア8の外周の所定部分にブリッジ11、19を切断させた後の残存突起11a、19aが残った状態となることが予測される。

【0023】次に、板状枠体6から取り外したICキャリア8を、携帯電話機等の機器のICキャリア装着部に対して装着する場合を、図8及び図9に基づいて説明する。図8に示した携帯電話機等の機器13のICキャリア装着部14は、ICキャリア8のICモジュール7の接続端子と接触させるための装着部接続端子15と、ICキャリアの傾斜状切り欠き辺12を有しない側の辺を先頭にして、ICキャリアの長手方向に移動させて装着させるためのスライド部16a、16bと、前記移動させたICキャリア8の先端辺を突き当てて位置決めする突き当たり部17とを有するガイド枠18を有している。

【0024】ICキャリア装着部14にICキャリア8を装着させる場合には、図8に示すように、ICキャリア8の接続端子が装着部接続端子15と接触可能とする状態(図8において、ICキャリア8の接続端子は裏側

にくる)で、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12を有していない側の辺を先頭にして、ICキャリア8をスライド部16a、16bの間に挿入させ、突き当たり部17に突き当てて装着状態とする。

【0025】この場合において、ICキャリア装着部14に装着されたICキャリア8の残存突起11a、19aは、ガイド枠18のスライド部16a、16bや突き当たり部17と接触しない箇所にくるので、残存突起11a、19aに影響されることなくICキャリア装着部14のガイド枠18の内部に装着される。これにより、ICキャリア8の接続端子がICキャリア装着部14の装着部接続端子15と確実に接触状態とさせることができる。

【0026】次に、本発明の第3実施形態に係るICカードを、図10乃至図12に基づいて説明する。第3実施形態に係るICカード1Cは、ICキャリア8を携帯電話機等の機器のICキャリア装着部に対して装着する際に、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12が形成された側を先頭にし、ICキャリア8の短辺方向にスライドさせて装着させる装着方式に適する構成を有するものである。

【0027】第3実施形態に係るICカード1Cには、図10に示すように、ICキャリア8の上側辺と傾斜状切り欠き辺12の所定箇所とに、スリット部9を介して板状枠体6と接続状態となるブリッジ11、20がそれぞれ備えられている。ICキャリア8は、上方または下方から圧力を加えて押し出すことで、ブリッジ11、20を切断させ、板状枠体6からICキャリア8を分離させることができる。

【0028】ICキャリア8を板状枠体6から取り外して分離させた場合には、図11に示すように、ICキャリア8の外周の所定部分にブリッジ11、20を切断させた後の残存突起11a、20aが残った状態となることが予測される。

【0029】次に、板状枠体6から取り外したICキャリア8を、携帯電話機等の機器のICキャリア装着部14に対して装着する場合を、図11及び図12に基づいて説明する。図11に示した携帯電話機等の機器13のICキャリア装着部14は、ICキャリア8のICモジュール7の接続端子と接触させるための装着部接続端子15と、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12を有する側の長辺を先頭にして移動させて装着させるためのスライド部16a、16bと、前記移動させたICキャリア8の先端辺を突き当てて位置決めする突き当たり部17とを有するガイド枠18を有している。

【0030】ICキャリア装着部14にICキャリア8を装着させる場合には、図12に示すように、ICキャリア8の接続端子が装着部接続端子15と接触可能とする状態(図12において、ICキャリア8の接続端子は裏側にくる)で、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺1

2を有する長辺を先頭にして、ICキャリア8をスライド部16a、16bの間に挿入させ、突き当たり部17に突き当てて装着状態とする。

【0031】この場合において、ICキャリア装着部14に装着されたICキャリア8の残存突起11a、20aは、ガイド枠18のスライド部16a、16bや突き当たり部17と接触しない箇所にくるので、残存突起11a、20aに影響されることなくICキャリア装着部14のガイド枠18の内部に装着される。これにより、ICキャリア8の接続端子がICキャリア装着部14の装着部接続端子15と確実に接触状態とさせることができる。

【0032】次に、本発明の第4実施形態に係るICカードを、図13乃至図15に基づいて説明する。第4実施形態に係るICカード1Dは、ICキャリア8を携帯電話機等の機器のICキャリア装着部に対して装着する際に、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12が形成された側と反対側の長辺を先頭にし、ICキャリア8の短辺に平行にスライドさせて装着させる装着方式に適する構成を有するものである。

【0033】第4実施形態に係るICカード1Dには、図13に示すように、ICキャリア8の下側辺と傾斜状切り欠き辺12の所定箇所とに、スリット部9を介して板状枠体6と接続状態となるブリッジ11、21がそれぞれ備えられている。ICキャリア8は、上方または下方から圧力を加えて押し出すことで、ブリッジ11、21を切断させ、板状枠体6からICキャリア8を分離させることができる。

【0034】ICキャリア8を板状枠体6から取り外して分離させた場合には、図14に示すように、ICキャリア8の外周の所定部分にブリッジ11、21を切断させた後の残存突起11a、21aが残った状態となることが予測される。

【0035】次に、板状枠体6から取り外したICキャリア8を、携帯電話機等の機器のICキャリア装着部14に対して装着する場合を、図14及び図15に基づいて説明する。図14に示した携帯電話機等の機器13のICキャリア装着部14は、ICキャリア8のICモジュール7の接続端子と接触させるための装着部接続端子15と、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺12を有する側の長辺と反対側の長辺を先頭にして移動させて装着させるためのスライド部16a、16bと、前記移動させたICキャリア8の先端辺を突き当てて位置決めする突き当たり部17とを有するガイド枠18を有している。

【0036】ICキャリア装着部14にICキャリア8を装着させる場合には、図14に示すように、ICキャリア8の接続端子が装着部接続端子15と接触可能とする状態(図14において、ICキャリア8の接続端子は裏側にくる)で、ICキャリア8の傾斜状切り欠き辺1

2を有する長辺と反対側の長辺を先頭にして、ICキャリア8をスライド部16a、16bの間に挿入させ、突き当たり部17に突き当てて装着状態とする。

【0037】この場合において、ICキャリア装着部14に装着されたICキャリア8の残存突起11a、21aは、ガイド枠18のスライド部16a、16bや突き当たり部17と接触しない箇所にくるので、残存突起11a、21aに影響されることなくICキャリア装着部14のガイド枠18の内部に装着される。これにより、ICキャリア8の接続端子がICキャリア装着部14の装着部接続端子15と確実に接触状態とさせることができる。

【0038】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のICカードは、携帯電話機等の機器のICキャリア装着部にICキャリアを装着した場合でも、ICキャリア装着部と接触するICキャリアの外周の部分にはブリッジが形成されていないので、板状枠体からICキャリアを取り外すときに残存突起が生じたとしても、この残存突起の影響でICキャリアがICキャリア装着部の正しい位置に装着されないという支障を生じることがないという効果がある。また、本発明のICカードの使用方法は、ICキャリアを機器に設けられたICキャリア装着部に装着する際に、切断したブリッジの部分がICキャリア装着部の内側面と接触しない状態で装着するので、ブリッジの残存突起の影響でICキャリアがICキャリア装着部の正しい位置に装着されないという支障を生じることがないという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係るICカードの平面図である。

【図2】図1のA-A線断面図である。

【図3】図2に示す状態においてICキャリアを板状枠体から取り外した状態を示す断面図である。

【図4】本発明の第1実施形態に係るICカードにおいて、ICキャリアを板状枠体から取り外した状態を示す一部平面図である。

【図5】本発明の第1実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図である。

【図6】本発明の第1実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図である。

【図7】本発明の第2実施形態に係るICカードの平面図である。

【図8】本発明の第2実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図である。

【図9】本発明の第2実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着さ

せた状態を示す平面図である。

【図10】本発明の第3実施形態に係るICカードの平面図である。

【図11】本発明の第3実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図である。

【図12】本発明の第3実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図である。

【図13】本発明の第4実施形態に係るICカードの平面図である。

【図14】本発明の第4実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させる状態を示す平面図である。

【図15】本発明の第4実施形態に係るICカードのICキャリアを、携帯電話機のICキャリア装着部に装着させた状態を示す平面図である。

【図16】従来のICカードを示す平面図である。

【図17】従来のICカードから取り外したICキャリアの平面図である。

【符号の説明】

1A 本発明の第1実施形態に係るICカード

1B 本発明の第2実施形態に係るICカード

1C 本発明の第3実施形態に係るICカード

1D 本発明の第4実施形態に係るICカード

2 コアシート

3, 4 オーバーシート

5 カード基材

6, 32 板状枠体

7, 31 ICモジュール

8, 35 ICキャリア

9, 33 スリット部

10, 11, 19, 20, 21, 34 ブリッジ

10a, 11a, 19a, 20a, 21a, 34a ICキャリア側における残存突起

10b, 11b 板状枠体側における残存突起

12 傾斜状切り欠き辺

13 携帯電話機等の機器

14 ICキャリア装着部

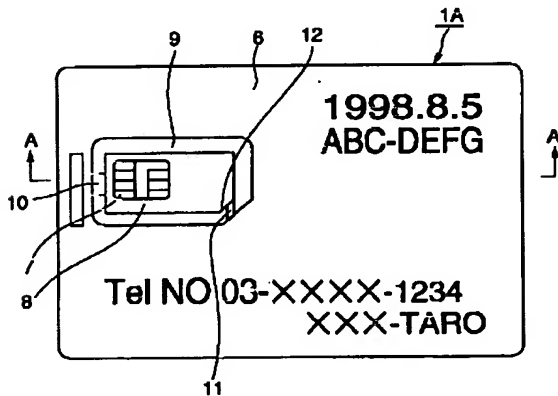
15 装着部接続端子

16a, 16b スライド部

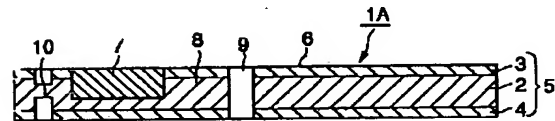
17 突き当たり部

30 従来のICカード

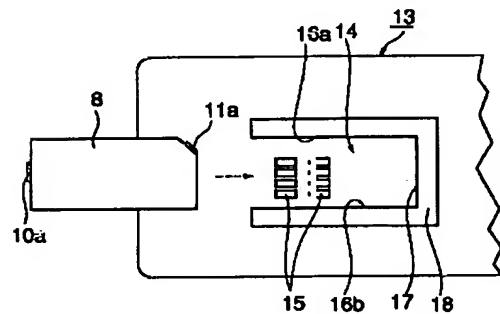
【図1】



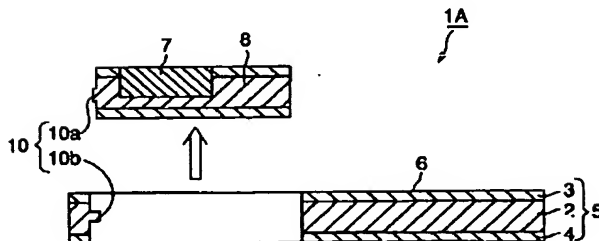
【図2】



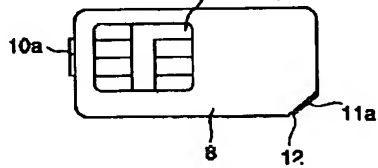
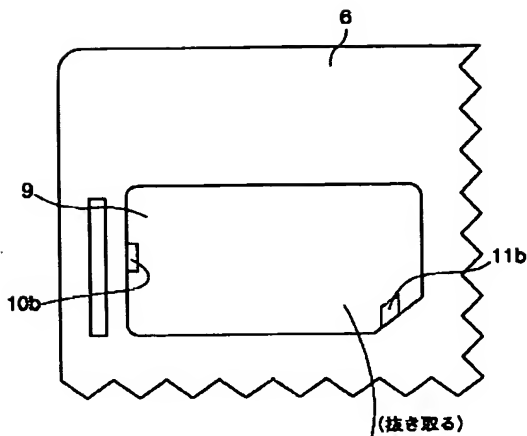
【図5】



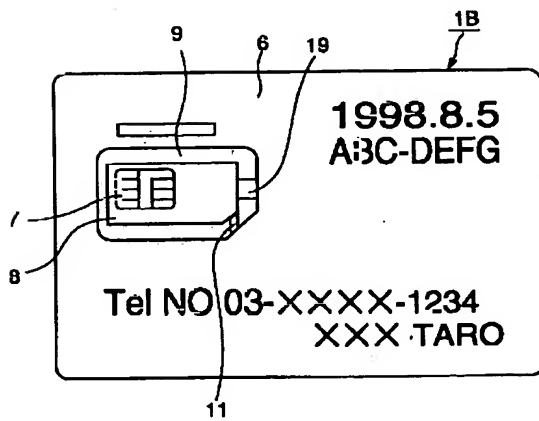
【図3】



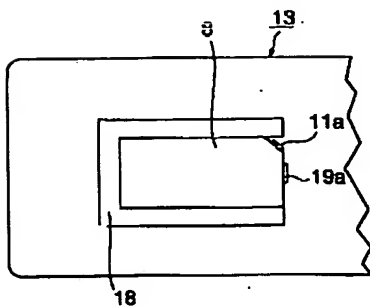
【図4】



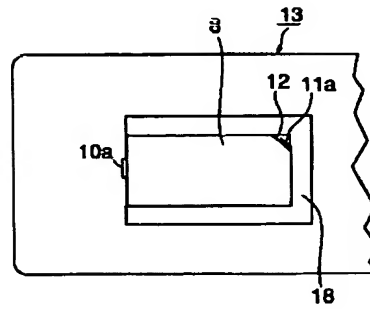
【図7】



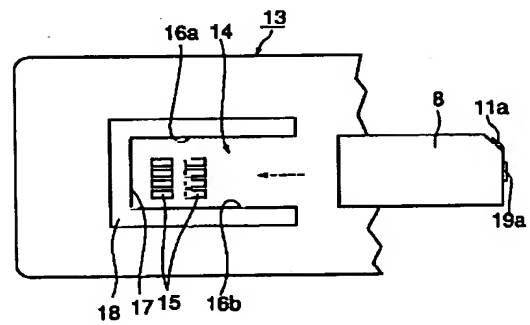
【図9】



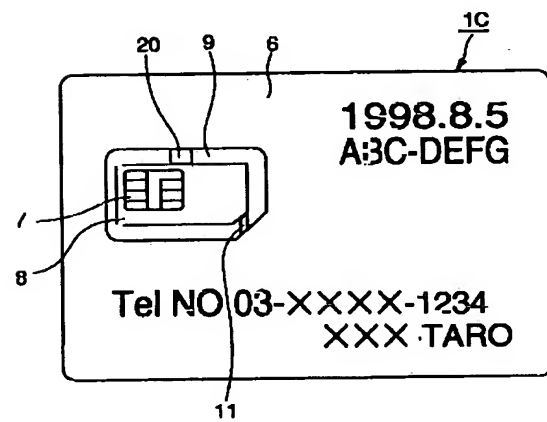
【図6】



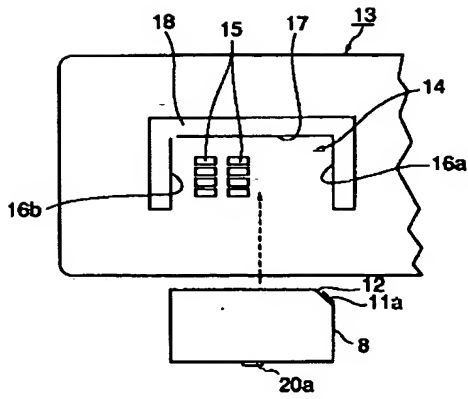
【図8】



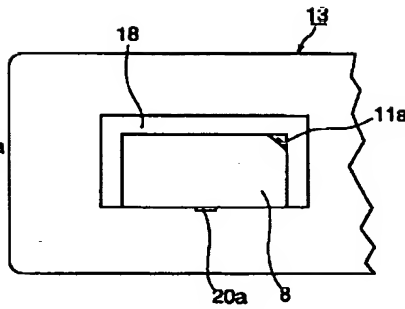
【図10】



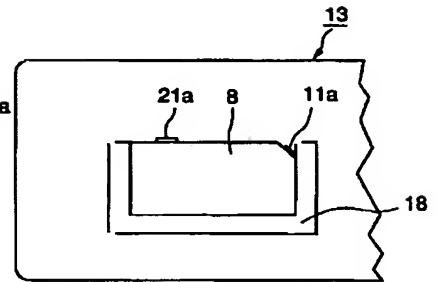
【図11】



【図12】

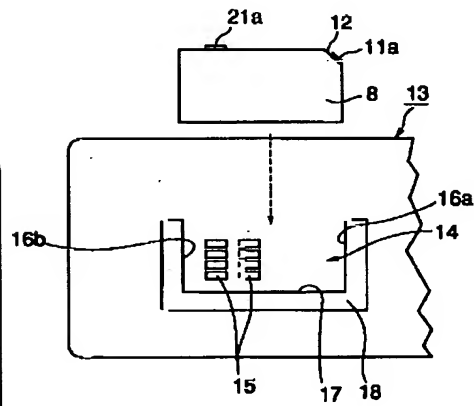
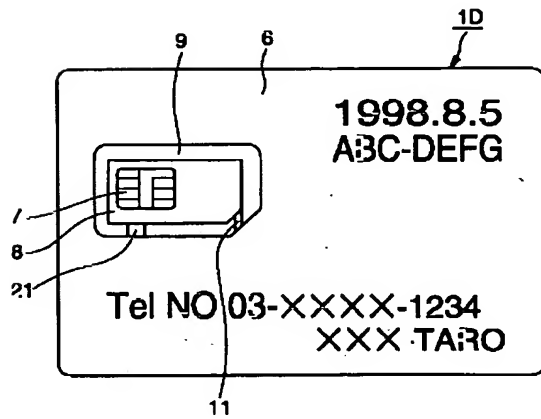


【図15】



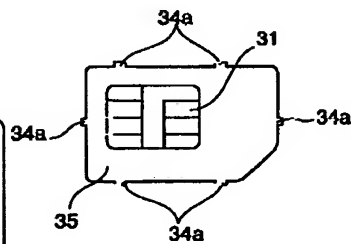
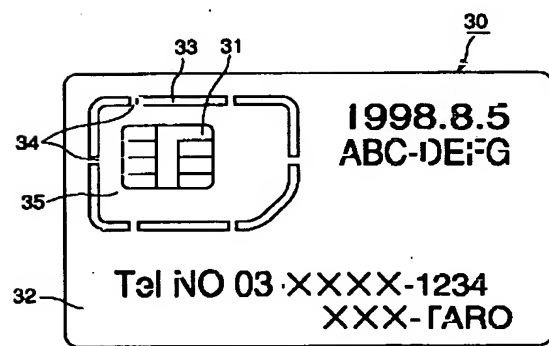
【図14】

【図13】



【図17】

【図16】



フロントページの続き

(72)発明者 草薙 司
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内

Fターム(参考) 2C005 MA31 MB10 NA03 NB19 NB24
PA03 QC04
5B035 BA02 BA03 BA05 BB09 BC00
CA01 CA08
5K023 AA07 BB20 PP12
5K067 AA21 BB04 BB21 BB34 EE02
KK17